

DIN EN 60749-19

ICS 31.080.01

Ersatz für
DIN EN 60749-19:2003-10

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 19: Prüfung der Chip-Bondfestigkeit (IEC 60749-19:2003 + A1:2010);
Deutsche Fassung EN 60749-19:2003 + A1:2010**

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 19: Die shear strength (IEC 60749-19:2003 + A1:2010);
German version EN 60749-19:2003 + A1:2010

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 19: Résistance de la pastille au cisaillement (CEI 60749-19:2003 + A1:2010);
Version allemande EN 60749-19:2003 + A1:2010

Gesamtumfang 8 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2003-04-01 angenommene Europäische Norm und die am 2010-09-01 angenommene Änderung A1 als DIN-Norm ist 2011-01-01.

Daneben darf DIN EN 60749-19:2003-10 noch bis 2013-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-19/A1:2009-10.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Die Änderung A1 wurde durch eine senkrechte Linie am linken Rand gekennzeichnet.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749-19:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) im Anwendungsbereich wurde entsprechend EN 60749-19/A1:2010-09 eine zweite Anmerkung (Abschnitt 1, Anmerkung 2) eingefügt, welche die unterschiedliche Anwendung bei hohlraumlosen Gehäusen und Gehäusen mit Hohlraum klarstellt;
- b) Verweis in Abschnitt 7, Punkt a) der Deutschen Fassung der EN korrigiert.

Frühere Ausgaben

DIN 41794-1: 1972-06

DIN IEC 60749: 1987-09

DIN EN 60749: 2000-02, 2001-09, 2002-09

DIN EN 60749-19: 2003-10

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 19: Prüfung der Chip-Bondfestigkeit
(IEC 60749-19:2003 + A1:2010)**

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 19: Die shear strength
(IEC 60749-19:2003 + A1:2010)

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 19: Résistance de la pastille au
cisaillement
(CEI 60749-19:2003 + A1:2010)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2003-04-01 und die A1 am 2010-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel